

Investor Relations 2026



**1Q26 Earning Release**

**SEMIFIVE : AI 전용 반도체 발전의 중심에 서다**

The Global Hub of Custom Silicon



# DISCLAIMER

---

회사는 본 자료에 서술된 경영실적의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료 작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 갱신 관련 책임을 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 이에 기재되거나 암시된 내용과 실제 결과 사이에는 중대한 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

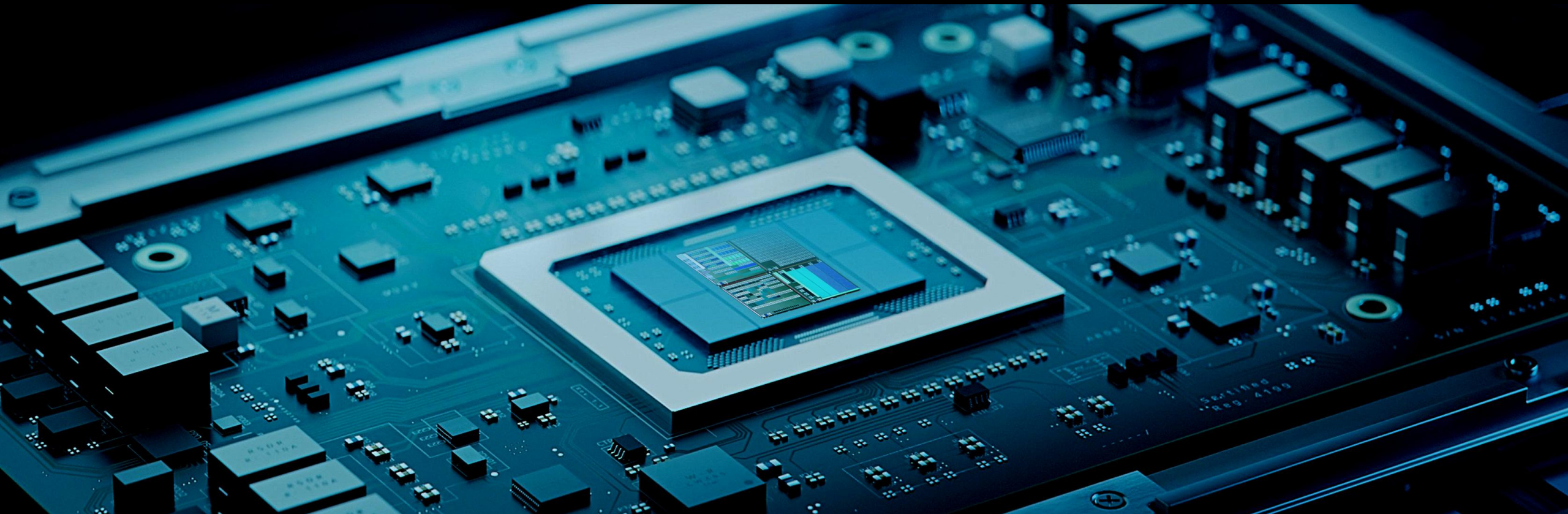
이 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고 자료로 작성된 것으로, 당사 및 당사의 임직원들은 이 자료의 내용과 관련하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증도 제공하지 아니하며, 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

본 자료는 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

**01**

**COMPANY OVERVIEW**

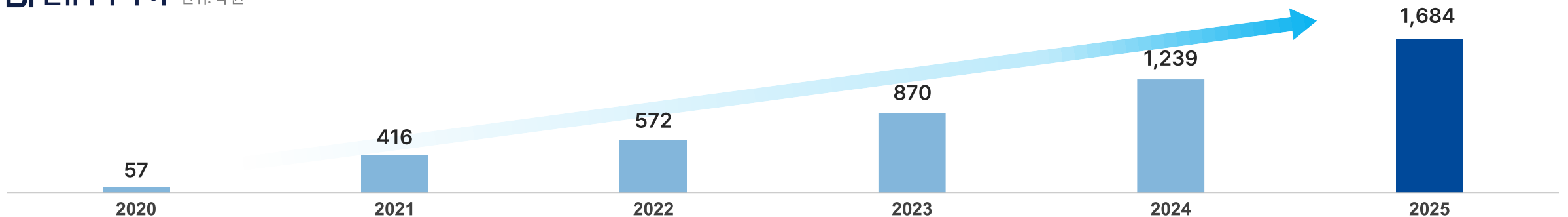
- 01.** Corporate Identity
- 02.** 사업 경쟁력 (1)(2)(3)
- 03.** 경영 성과



## 빠르게 성장하는 AI ASIC 시장에서 차별화된 경쟁 우위 확보

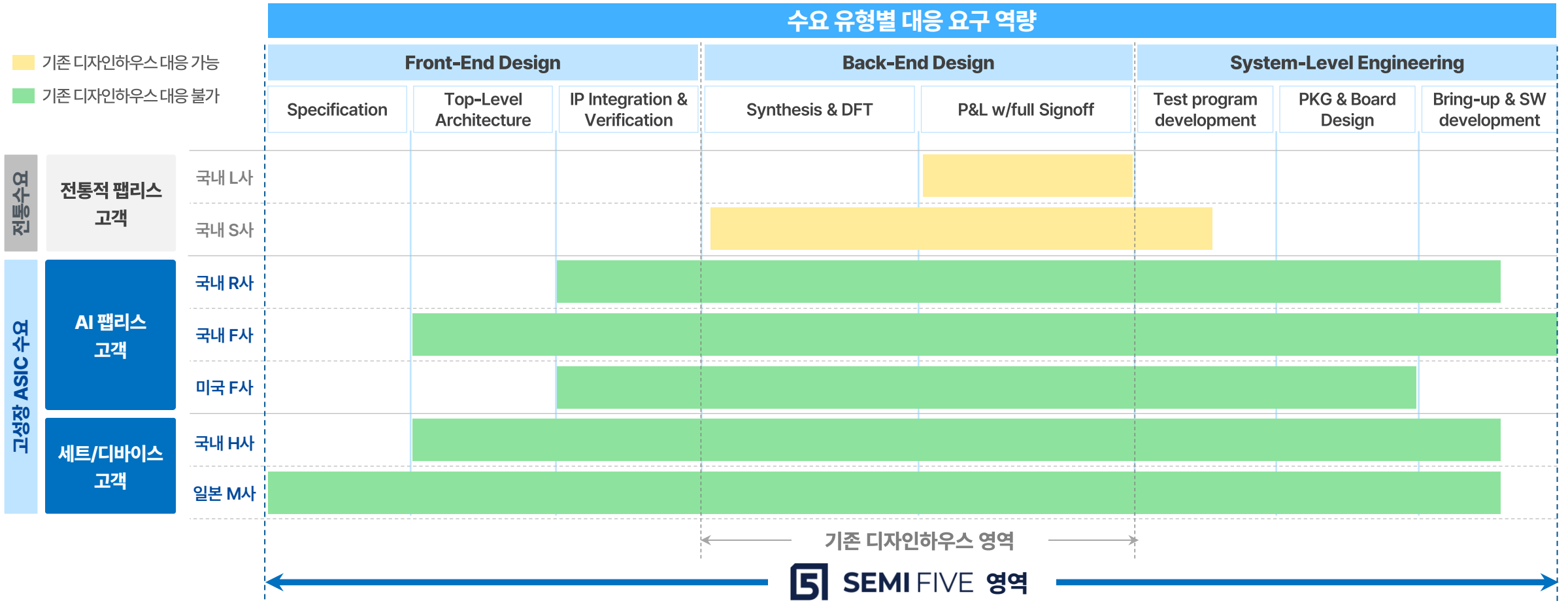


신규수주 추이 단위: 억 원



주) K-IFRS 연결 기준

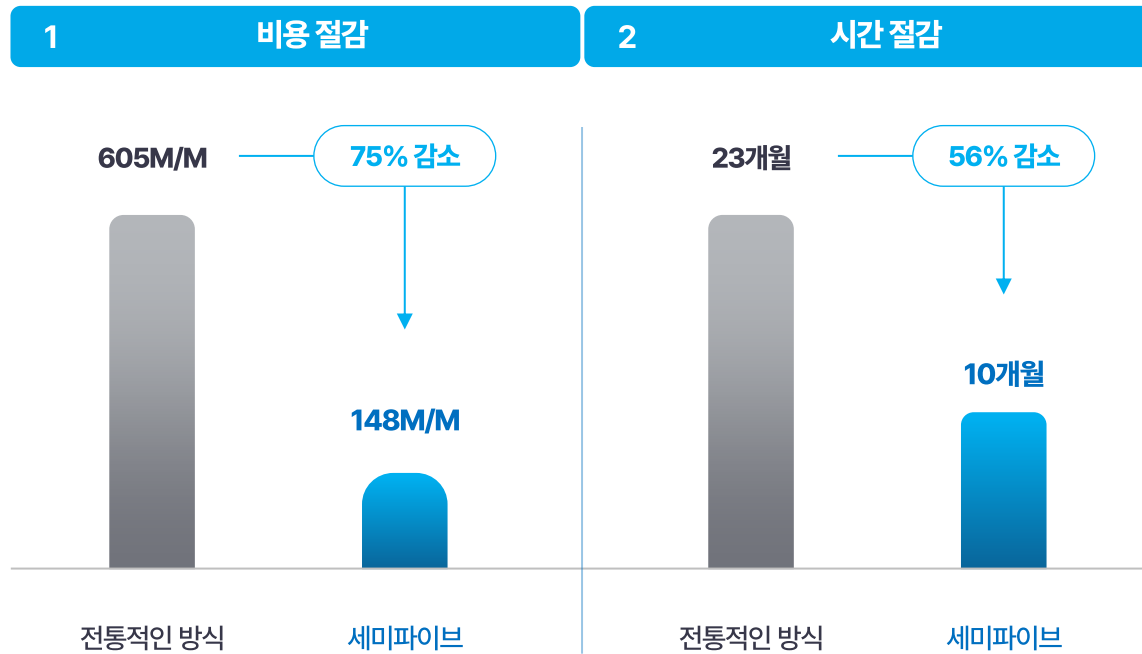
[COVERAGE] AI ASIC 시장 전체를 TAM으로 하는 End-to-End 개발 역량 확보



### [SCALABILITY] 독자적 설계 기술 기반 성장 동력 및 수익성 극대화

#### 설계 플랫폼 도입 효과

<사례: 14nm AI 가속기 프로젝트>

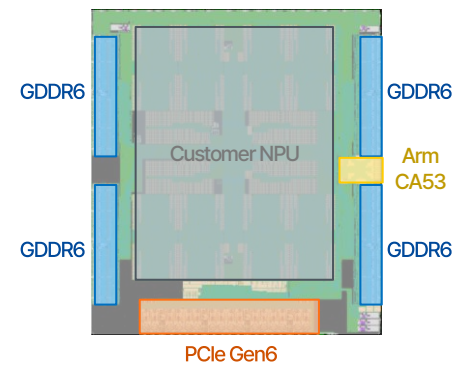


엔지니어 경험에 의존하는 전통적인 방식 대비 기술자산을 활용하며 개발 효율성 확보

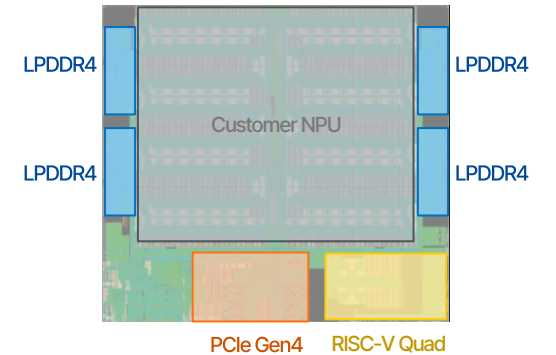
#### 주요 설계 플랫폼 기술자산

Reusable Subsystem 리스트				
CPU	Arm Cortex-A53	Arm Neoverse N2	RISC-V Dual	RISC-V Quad
Memory	LPDDR4	LPDDR5	LPDDR5x	GDDR6
High-speed I/F	PCIe Gen4	PCIe Gen5	PCIe Gen6	UCIe 1.1

<사례1: 5nm AI 가속기>



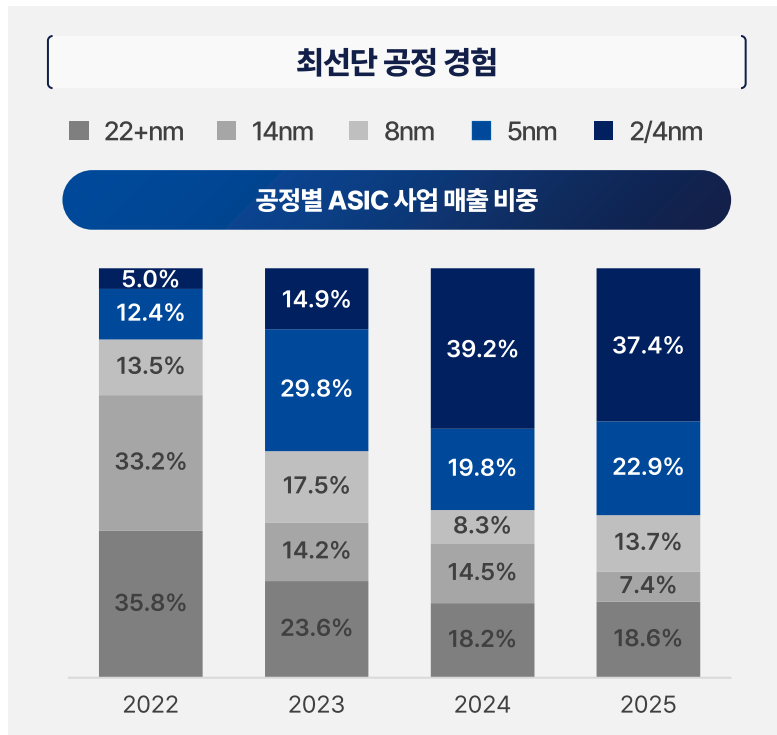
<사례2: 14nm AI 가속기>



자체 개발 디자인엔진 기반 기술자산을 재사용하며 제품 요구조건에 맞춰 자동 설계·검증 수행

### [TECHNOLOGY] 최선단 공정, Big Die, 고성능 Subsystem까지 차별화된 Track Record 보유

#### SEMI FIVE 고성능 AI 반도체 개발 위한 필수 역량



최선단 공정(2~5nm) 관련 전문성 보유

##### Big Die 프로젝트 경험

일반적인 반도체  
~100mm<sup>2</sup> Die Size : ~100mm<sup>2</sup>

세미파이브 턴키 수행 이력

Die Size : 500mm<sup>2</sup> (4nm)  
HYPER ACCEL

Die Size : 500/800mm<sup>2</sup> (8nm)  
아시아 HPC향 AI 반도체 기업 P사

Project in Progress

고도화된 설계역량을 요구하는 다양한 Big Die 턴키 프로젝트 수행 경험 보유

##### 고성능 Subsystem 설계 경험

##### Computing

arm Cortex CPU Neoverse SiFive RISC-V CPU ...

##### High-Speed Interface

PCIe Gen4/5/6 UCIe ...  
CXL 3.0 UALink 200

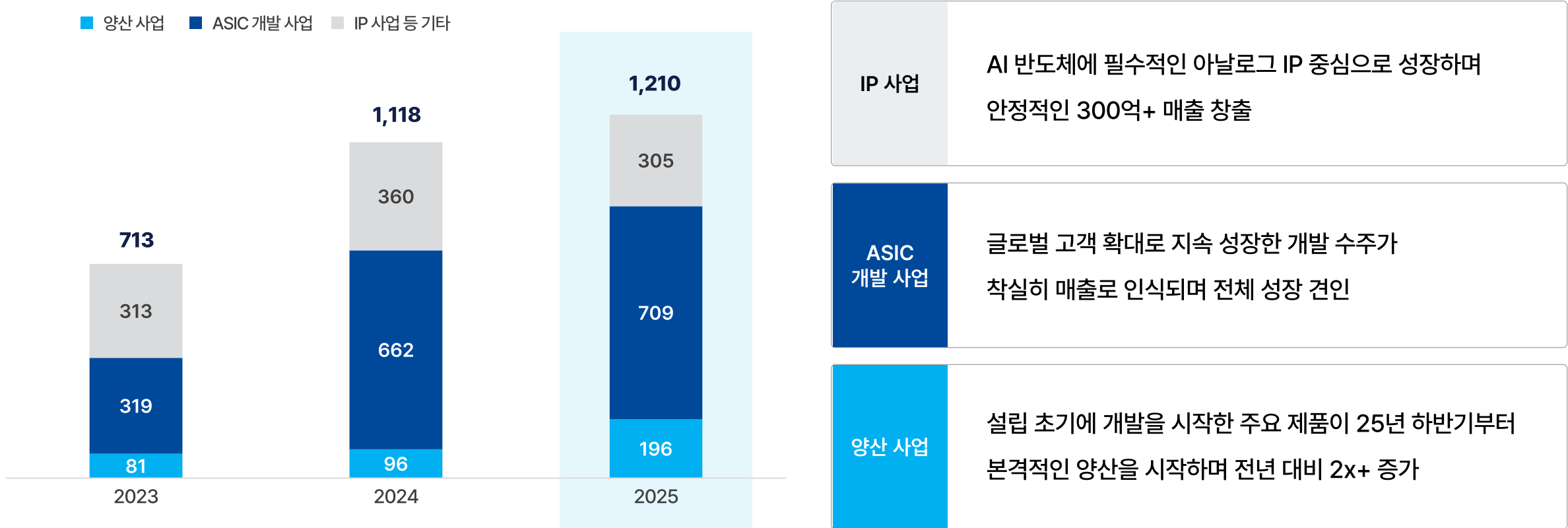
##### Memory Subsystem

GDDR6 HBM3/4 LPDDR4/5/5X/6 ...

고성능 AI 반도체 핵심 기술에 대한 설계 역량 보유

IP·ASIC 개발 사업의 지속적인 매출 성장과 함께 양산 사업 중심 성장 기반 확보

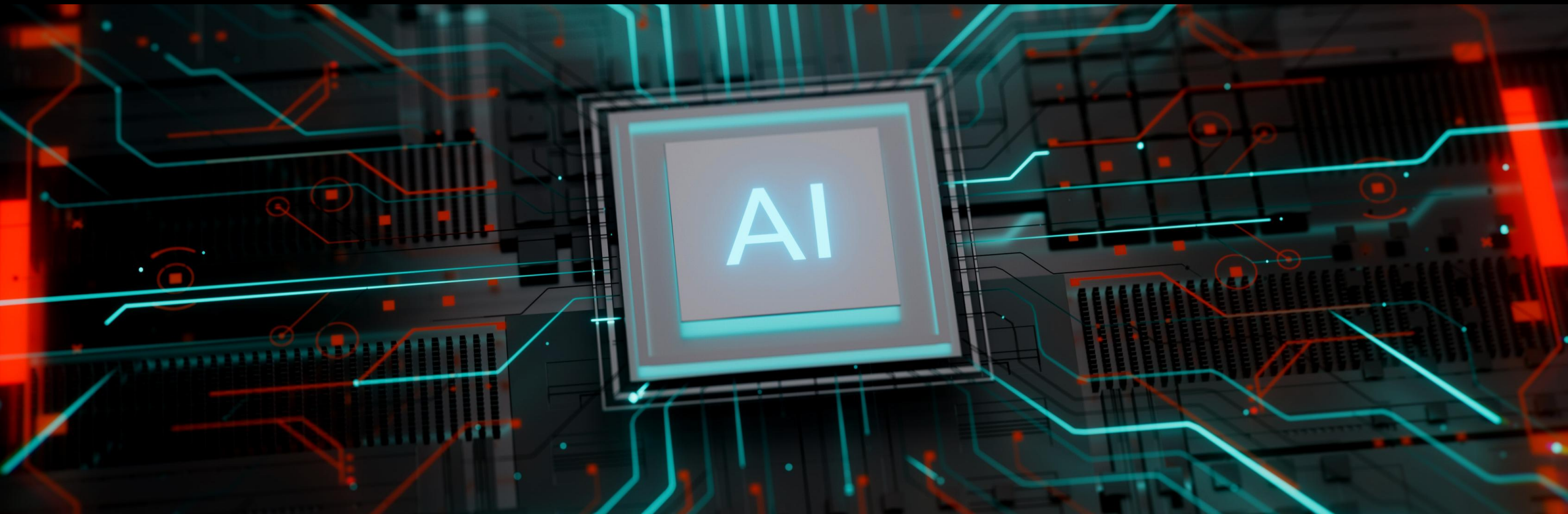
사업 영역별 매출액 단위: 억 원



주) K-IFRS 연결 기준

**01.** 1Q26 경영실적 (1)(2)(3)(4)

**02.** 성장 로드맵

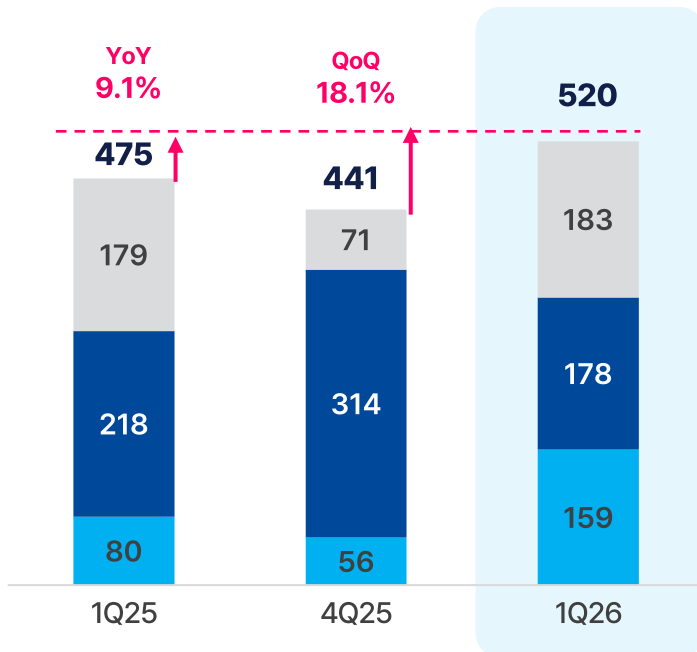


## 글로벌 확장과 양산 본격화로 성장·수익성 동시 확보

### 신규수주

단위: 억 원

■ 양산 사업 ■ ASIC 개발 사업 ■ IP 사업 등 기타

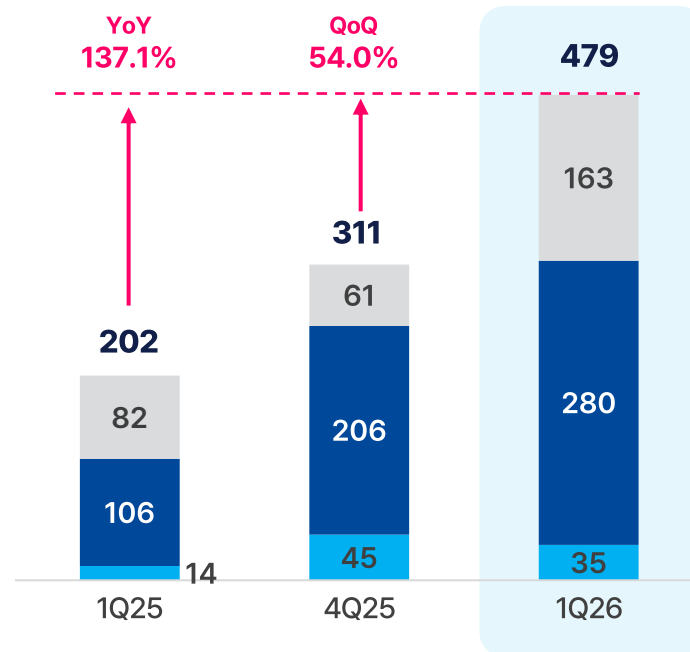


양산 사업 수주의 본격적인 확대가 시작되며 성장세 지속

### 매출액

단위: 억 원

■ 양산 사업 ■ ASIC 개발 사업 ■ IP 사업 등 기타

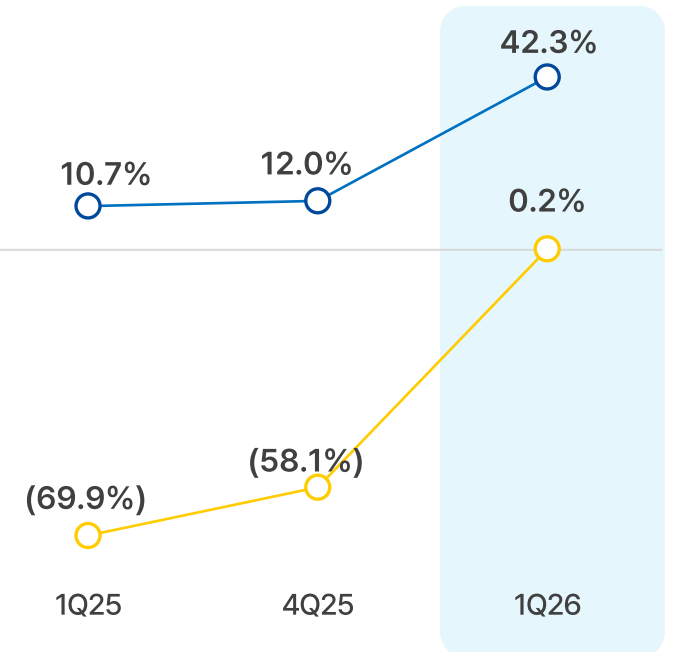


IP·개발 사업 수주의 매출 인식 본격화로 고성장 실현

### 매출총이익률 및 영업이익률

단위: %

○ 매출총이익률 ○ 영업이익률

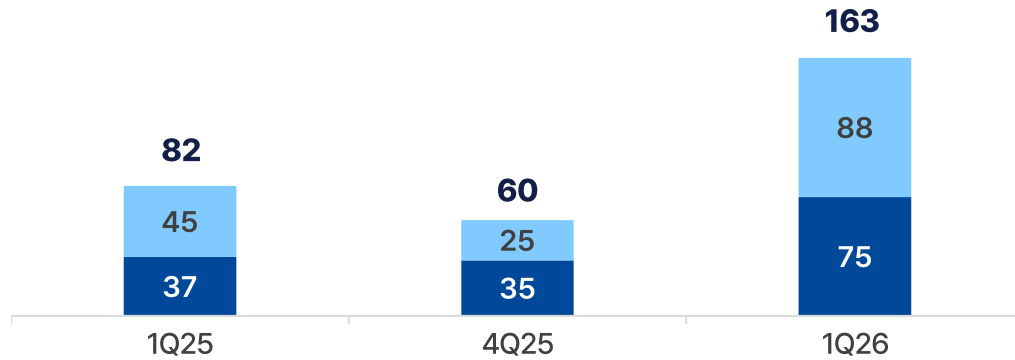


매출 성장 기반 수익성 큰 폭 개선

고수익 OTS · 선단 공정 IP 중심 사업 전환으로 안정적 성장 기반 확보

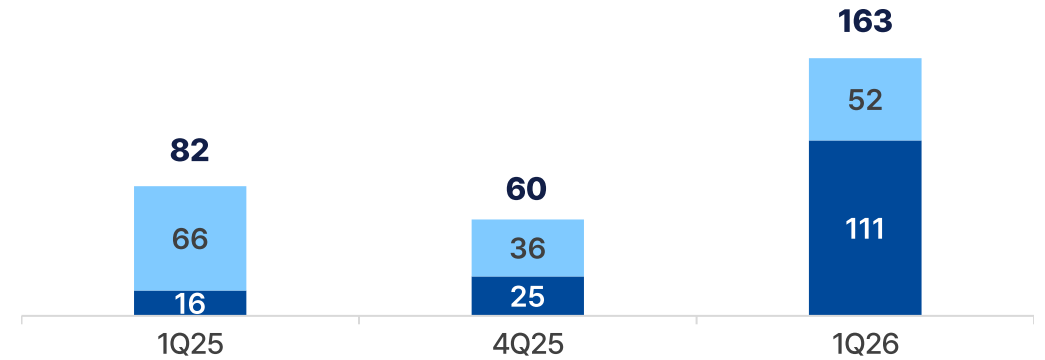
세부 사업 영역별 매출액

■ OTS(Off-The-Shelf) ■ Custom 등      단위: 억 원



공정별 매출액

■ 2/3nm ■ 2/3nm 외      단위: 억 원



Custom → OTS 선순환 사업구조 확보

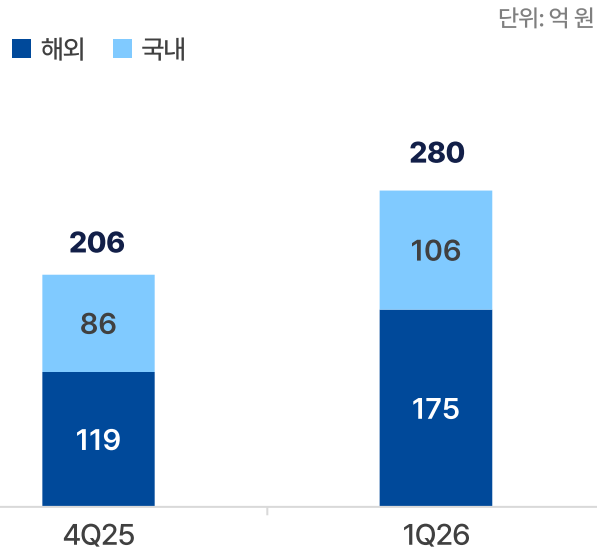
- Custom 프로젝트 수행을 통해 IP 포트폴리오 지속 확대
- 확보된 IP를 활용한 고수익 OTS 사업 전개로 수익성 강화

데이터센터 AI ASIC 수요 확대에 따른 고부가 선단 공정 중심 사업 재편

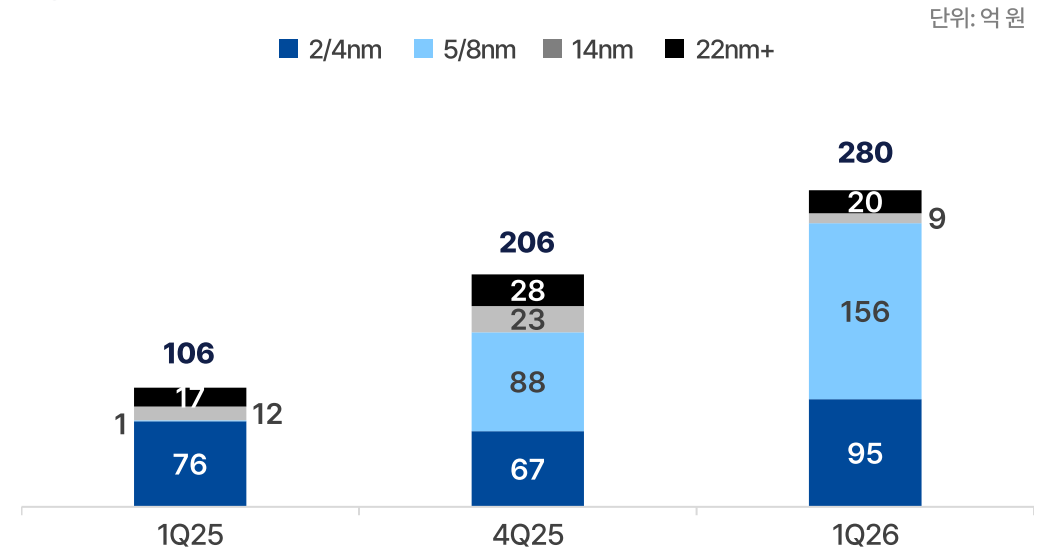
- 열관리 · 전력관리 중요성 확대에 따라 관련 아날로그 IP 수요 증가
- 데이터센터향 AI ASIC 중심으로 고부가 최선단 공정 제품 비중 확대

글로벌 고객 기반 실적 확대와 고부가 선단 공정 중심 매출 성장 지속

고객 지역별 매출액



공정별 매출액



글로벌 수주 확대 기반 해외 매출 성장 본격화

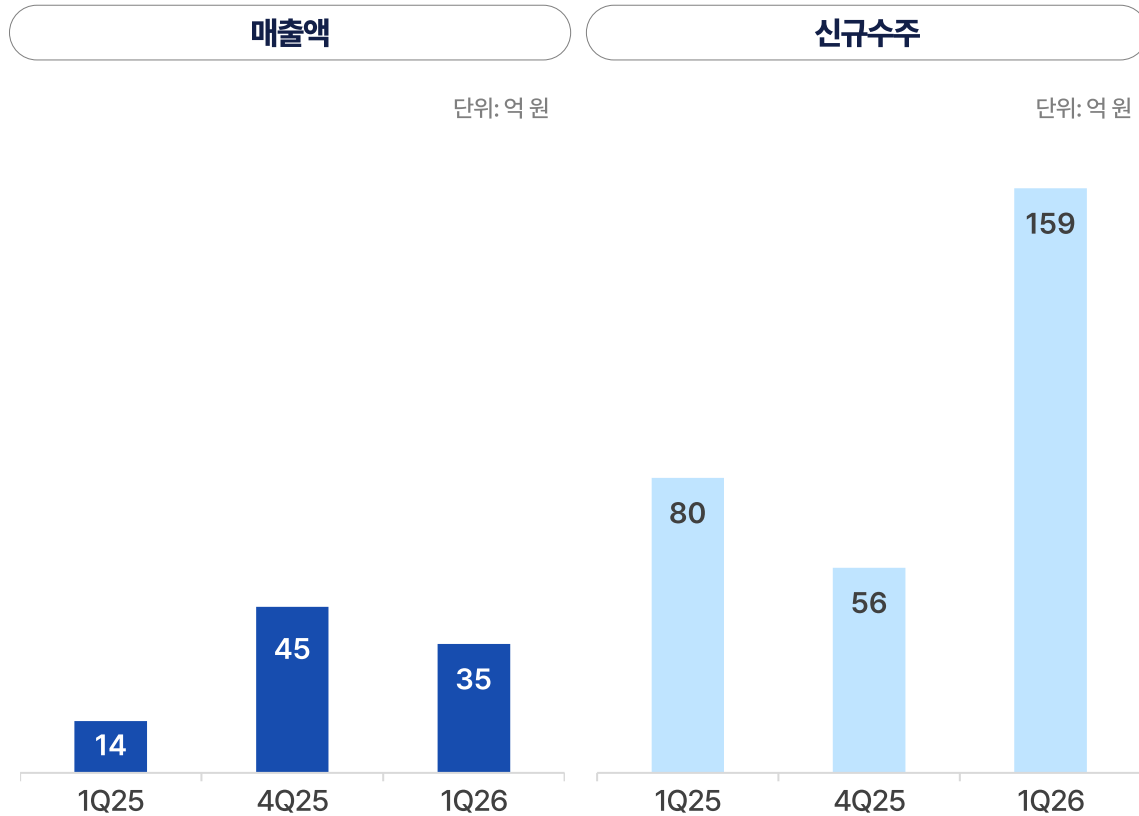
- 2025년부터 급증한 해외 수주를 기반으로 해외 매출 비중 빠르게 확대
- 북미·일본 시장 중심의 글로벌 매출 성장세 지속 전망

선단공정 기반 균형 잡힌 AI ASIC 사업 포트폴리오 확보

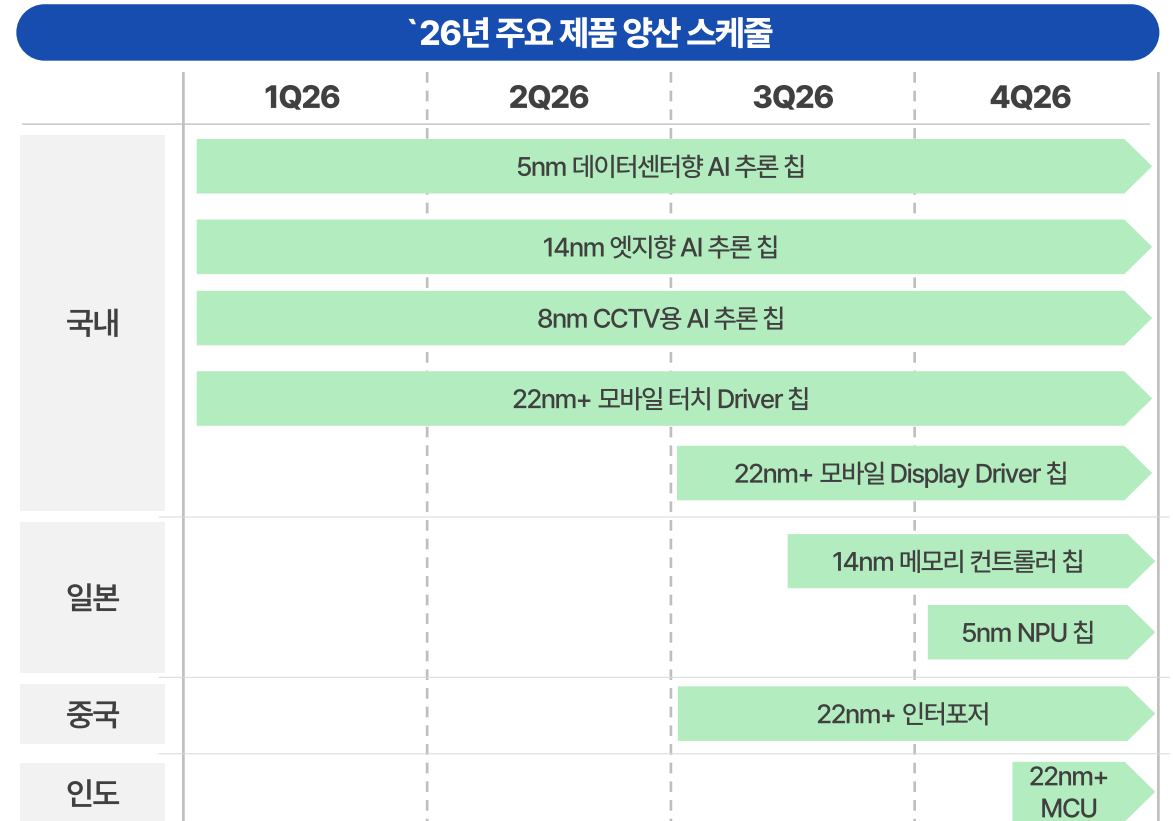
- 고부가 데이터센터향 AI ASIC 중심의 2/4nm 사업 확대
- 높은 양산성을 갖춘 엣지·디바이스 AI ASIC 중심의 5/8nm 포트폴리오 강화

작년 하반기부터 시작된 양산 성장세가 1Q26에도 이어지며, 후속 양산 파이프라인도 계획대로 확대 중

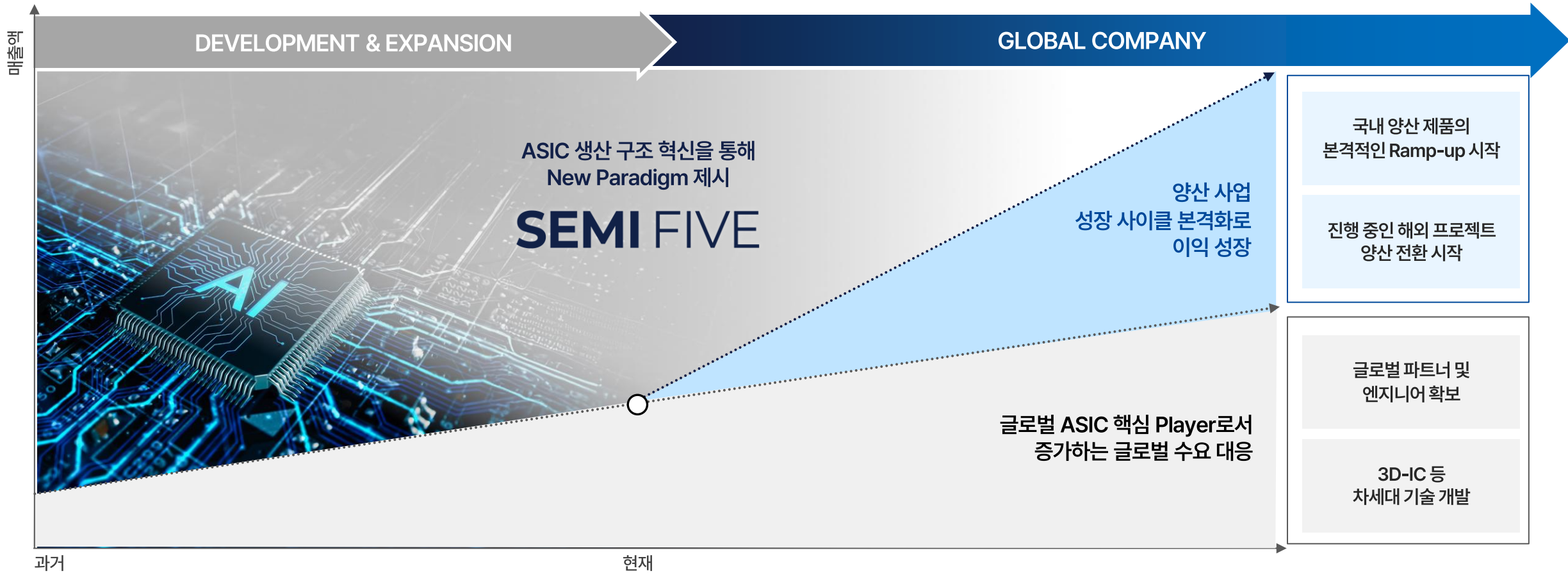
5 매출액 및 신규수주



5 주요 양산 파이프라인



### 양산 확대와 글로벌 확장 기반 성장 사이클 본격화



VISION

**New Global Hub of  
Custom Silicon**

MISSION

“시스템 반도체를 더 싸고, 빠르고, 쉽게  
개발할 수 있게 만드는 기업”